

請求の範囲

- [請求項1] 半導体ウエハに保護テープを貼り付けるための貼付装置において、
 基材上に仮着された前記保護テープを剥離位置まで搬送するテープ
 搬送機構と、
 前記保護テープを保持可能なテープ保持体と、
 前記テープ保持体を前記剥離位置に移動させる保持体移動機構と、
 前記剥離位置で前記テープ保持体に保持された前記保護テープから
 前記基材を剥離する剥離機構と、を少なくとも備える、保護テープの
 貼付装置。
- [請求項2] 前記半導体ウエハがマウントされるダイシングフレームを支持する
 フレーム台をさらに備え、
 前記保持体移動機構は、前記テープ保持体を前記フレーム台上に移
 動させて前記保護テープを前記ダイシングフレームに貼り付けるよう
 に構成される、請求項1に記載の保護テープの貼付装置。
- [請求項3] 前記半導体ウエハを支持する貼付テーブルと、
 前記貼付テーブルを昇降させる昇降機構と、をさらに備え、
 前記フレーム台は、前記貼付テーブルの周囲かつ上方に設けられ、
 前記昇降機構は、前記貼付テーブルを上昇させて前記半導体ウエハ
 に前記保護テープを貼り付けるように構成される、請求項2に記載の
 保護テープの貼付装置。
- [請求項4] 前記基材は、帯状であり、複数の前記保護テープが搬送方向に沿っ
 て間隔をあけて配置されており、
 前記剥離機構は、剥離板と、前記剥離板を前記基材の搬送方向に往
 復動させる剥離板移動機構と、を備えており、前記剥離板の先端で前
 記基材を折り返しながら前記剥離板を前記基材の搬送方向と反対方向
 に移動させることで、前記保護テープから前記基材を剥離する、請求
 項1～3のいずれかに記載の保護テープの貼付装置。
- [請求項5] 前記テープ保持体は、前記保護テープの全面を吸着可能な吸着部材

を備えている、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の保護テープの貼付装置。

[請求項6] 前記保持体移動機構は、前記テープ保持体を上下方向に移動させる上下移動機構と、前記テープ保持体を水平面に沿う X 方向及び Y 方向に直交する Y 方向に往復移動させる往復移動機構と、を備える、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の保護テープの貼付装置。

[請求項7] 半導体ウエハに保護テープを貼り付けるための貼付方法において、
基材上に仮着された前記保護テープを剥離位置まで搬送するテープ搬送工程と、

前記保護テープを保持可能なテープ保持体を前記剥離位置に移動させる保持体移動工程と、

前記剥離位置で前記テープ保持体に保持された前記保護テープから前記基材を剥離する剥離工程と、を有する、保護テープの貼付方法。

[請求項8] 前記テープ保持体をダイシングフレームを支持するフレーム台上に移動させて前記保護テープを前記ダイシングフレームに貼り付けるとともに前記半導体ウエハを前記保護テープを介して前記ダイシングフレームにマウントする工程をさらに有する、請求項 7 に記載の保護テープの貼付方法。